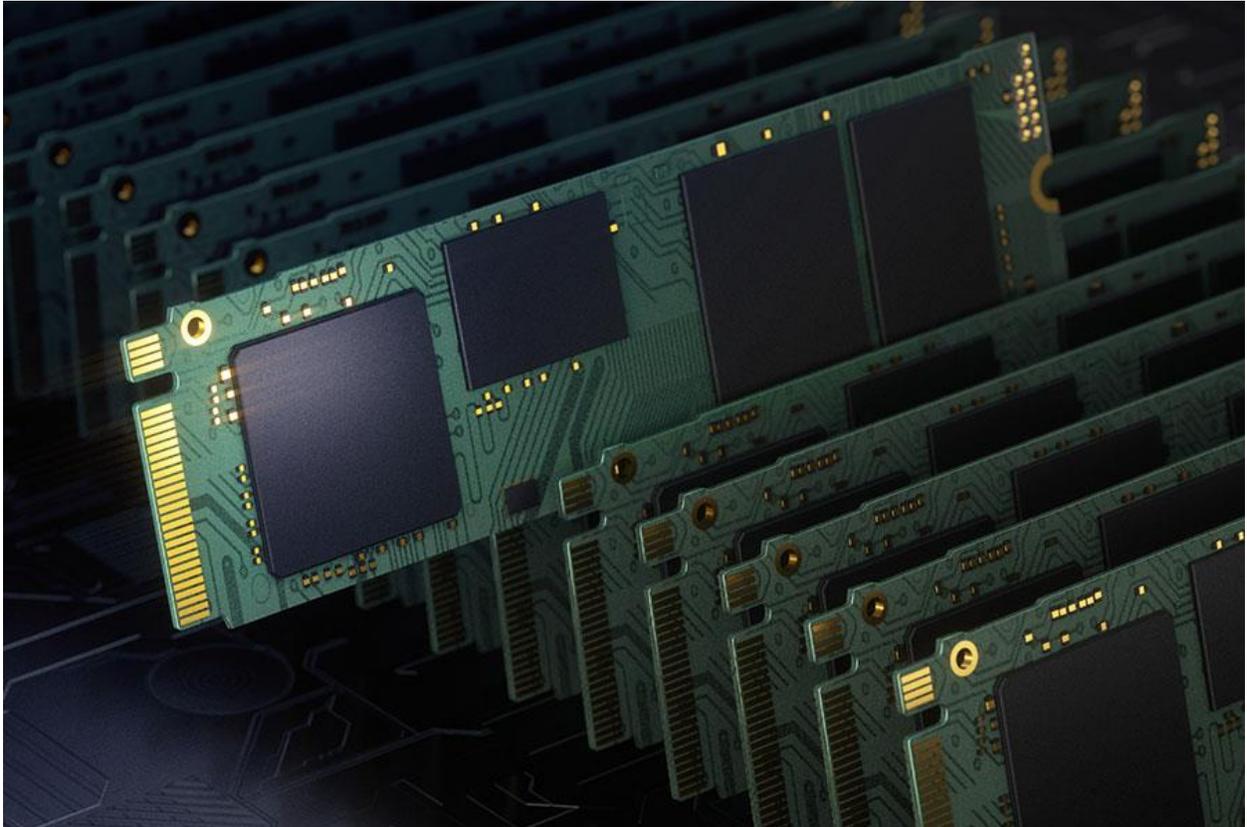


EVG: After yield improvement, HBM industry will apply W2W technology – August 7, 2023

EVG：良率改善后，HBM行业将应用W2W技术

作者：[孙乐](#) 08-07 13:56



集微网消息，据TheElec报道，半导体设备供应商EV Group（简称EVG）表示，在DRAM领域应用晶圆到晶圆（W2W）技术的研究非常活跃。

EV Group韩国总经理Justin Yun表示，这是因为W2W混合键合解决方案的应用可以提高高带宽内存（HBM）等产品的生产率。但由于缺陷问题，W2W技术的商业应用还需要一段时间。

但Justin Yun表示，一旦良率问题得到解决，该技术将应用于HBM生产。

在3D芯片产品中，除了W2W之外，还使用裸片到晶圆（Die-to-Wafer，D2W）和Die-to-Die键合技术。后两种方法的良率问题较少，因为良品芯片更容易被发现。然而，在吞吐量方面，它们落后于W2W。

就W2W而言，良率60%的晶圆在工艺完成后，良率将下滑至36%。随着堆叠的晶圆越来越多，产量下降得更多。

CMOS图像传感器和MEMS（微机电系统）最先采用W2W，因为这些芯片使用传统节点并且良率问题更容易解决。

Justin Yun表示，总有一天W2W会比其他键合方法更具价格竞争力。

他表示，这个时间段将出现W2W更多应用，而如果良率问题得到解决，使用W2W可以支持12至16个堆栈。

总部位于奥地利的EV Group是一家后端芯片公司，是为半导体、微机电系统（MEMS）、化合物半导体、功率器件和纳米器件制造提供大批量生产设备和工艺解决方案的供应商，提供晶圆键合机、薄晶圆加工和光刻/光刻纳米压印（NIL）设备、光刻胶涂布机，以及清洁和检测/计量系统。

（校对/张杰）

THE END

*此内容为集微网原创·著作权归集微网所有·爱集微·爱原创

<https://www.jiwei.com/n/871995>